

# HIMax®

Manual do módulo analógico de saída







Todos os produtos HIMA mencionados neste manual estão protegidos pela marca registrada da HIMA. A não ser que seja mencionado de outra forma, isso também se aplica aos outros fabricantes e seus produtos mencionados.

Todos os dados e avisos técnicos neste manual foram elaborados com o máximo de cuidado, considerando medidas de controle de garantia de qualidade efetiva. Em caso de dúvidas, dirija-se diretamente à HIMA. A HIMA ficaria grata por quaisquer sugestões, p. ex., informações que ainda devem ser incluídas no manual.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. A HIMA ainda se reserva o direito de modificar o material escrito sem avisar previamente.

Informações mais detalhadas encontram-se na documentação no CD-ROM e na nossa homepage em http://www.hima.com.

© Copyright 2011, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos os direitos reservados.

# **Contato**

Endereço da HIMA:
HIMA Paul Hildebrandt GmbH
Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0 Fax: +49 6202 709-107

E-Mail: info@hima.com

Índice	Alterações	Tipo de alteração	
de revisão		técnica	redacional
4.00	Adaptado ao SILworX V4 Edição em português (traduzida)		

# Índice

1	Introdução	5
1.1	Estrutura e utilização do manual	5
1.2	Grupo alvo	
1.3	Convenções de representação	6
1.3.1	Avisos de segurança	6
1.3.2	Avisos de utilização	7
2	Segurança	8
2.1	Utilização prevista	8
2.1.1	Requisitos de ambiente	8
2.1.2	Medidas de proteção contra ESD	8
2.2	Perigos residuais	9
2.3	Medidas de precaução de segurança	9
2.4	Informações para emergências	9
3	Descrição do produto	. 10
3.1	Função de segurança	10
3.1.1	Reação em caso de erro	10
3.2	Volume de fornecimento	10
3.3	Placa de identificação	11
3.4	Estrutura	12
3.4.1	Diagrama de blocos	12
3.4.2	Indicador	13
3.4.3	Indicador de status do módulo	
3.4.4	Indicador de barramento de sistema	
3.4.5	Indicador de E/S	
3.5	Dados do produto	
3.6	Connector Boards	
3.6.1	Codificação mecânica de Connector Boards	
3.6.2	Codificação de Connector Boards X-CB 014 5X	
3.6.3	Connector Boards com bornes aparafusados	
3.6.4	Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados	
3.6.5	Connector Boards com conector de cabo	
3.6.6	Atribuição de conectores Mono Connector Board com conector de cabo	
3.7	Cabo de sistema X-CA 011	
3.7.1	Codificação do conector de cabo	25

4	Colocação em funcionamento	26		
4.1	Montagem	26		
4.1.1	Ligação de saídas não utilizadas	26		
4.2	Instalação e desinstalação do módulo	27		
4.2.1	Montagem de uma Connector Board	27		
4.2.2	Instalação e desinstalação de um módulo			
4.3	Configuração do módulo no SILworX	31		
4.3.1	Registro Module			
4.3.2	Registro I/O Submodule AO16_01	33		
4.3.3	Registro I/O Submodule AO16_01: Channels			
4.3.4	Submodule Status [DWORD]			
4.3.5	Diagnostic Status [DWORD]			
4.4	Variantes de ligação			
4.4.1	Ligação de saída mono-canal			
4.4.2	Regulação			
4.4.3	Ligação via Field Termination Assembly			
4.4.4	Comportamento no caso de comunicação HART			
5	Operação	39		
5.1	Operação	39		
5.2	Diagnóstico	39		
6	Manutenção preventiva	40		
6.1	Medidas de manutenção preventiva	40		
6.1.1	Carregar o sistema operacional	40		
6.1.2	Repetição da verificação	40		
7	Colocação fora de serviço	41		
8	Transporte	42		
9	Eliminação			
	Anexo	45		
	Glossário	45		
	Lista de figuras	46		
	Lista de tabelas			
	Índica remissivo	48		

X-AO 16 51 1 Introdução

# 1 Introdução

O presente manual descreve as características técnicas do módulo e a sua utilização. O manual contém informações sobre a instalação, a colocação em funcionamento e a configuração do SILworX.

# 1.1 Estrutura e utilização do manual

O conteúdo deste manual é parte da descrição do hardware do sistema eletrônico programável HIMax.

O manual é dividido nos seguintes capítulos principais:

- Introdução
- Segurança
- Descrição do produto
- Colocação em funcionamento
- Operação
- Manutenção preventiva
- Colocação fora de serviço
- Transporte
- Eliminação

Adicionalmente devem ser observados os seguintes documentos:

Nome	Conteúdo	Nº do documento
Manual de sistema HIMax	Descrição do Hardware do sistema HIMax	HI 801 242 P
Manual de segurança HIMax	Funções de segurança do sistema HIMax	HI 801 241 P
Manual de comunicação HIMax	Descrição da comunicação e dos protocolos	HI 801 240 P
Ajuda Online SILworX (OLH)	Operação do SILworX	-
Primeiros passos	Introdução ao SILworX	HI 801 239 P

Tabela 1: Manuais adicionalmente em vigor

Os manuais atuais encontram-se na homepage da HIMA em www.hima.com. Com ajuda do índice de revisão na linha de rodapé, a atualidade de manuais eventualmente disponíveis pode ser comparada à versão na internet.

# 1.2 Grupo alvo

Este documento dirige-se a planejadores, projetistas e programadores de sistemas de automação, bem como pessoas autorizadas para colocação em funcionamento, operação e manutenção dos equipamentos e do sistema. Pressupõem-se conhecimentos especializados na área de sistemas de automatização direcionados à segurança.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 5 de 50

1 Introdução X-AO 16 51

# 1.3 Convenções de representação

Para a melhor legibilidade e para clarificação, neste documento valem as seguintes convenções:

**Negrito** Ênfase de partes importantes do texto.

Denominações de botões, itens de menu e registros no SILworX

que podem ser clicados.

Itálico Parâmetros de sistema e variáveis

Courier Introdução de dados tal qual pelo usuário

RUN Denominações de estados operacionais em letras maiúsculas Cap. 1.2.3 Notas remissivas são híperlinks, mesmo quando não são

especialmente destacadas. Ao posicionar o cursor nelas, o mesmo muda sua aparência. Ao clicar, o documento salta

para o respectivo ponto.

Avisos de segurança e utilização são destacados de forma especial.

# 1.3.1 Avisos de segurança

Os avisos de segurança no documento são representados como descrito a seguir. Para garantir o menor risco possível devem ser observados sem excepção. A estrutura lógica é

- Palavra sinalizadora: Perigo, Atenção, Cuidado, Nota
- Tipo e fonte do perigo
- Consequências do perigo
- Como evitar o perigo

#### A PALAVRA SINALIZADORA



Tipo e fonte do perigo! Consequências do perigo Como evitar o perigo

O significado das palavras sinalizadoras é

- Perigo: No caso de n\u00e3o-observ\u00e1ncia resultam les\u00f3es corporais graves at\u00e9 a morte
- Atenção: No caso de não-observância há risco de lesões corporais graves até a morte
- Cuidado: No caso de não-observância há risco de lesões corporais leves
- Nota: No caso de não-observância ha risco de danos materiais

#### **NOTA**



Tipo e fonte dos danos! Como evitar os danos

Página 6 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

X-AO 16 51 1 Introdução

# 1.3.2 Avisos de utilização Informações adicionais são estruturadas de acordo com o seguinte exemplo: Neste ponto está o texto das informações adicionais. Dicas úteis e macetes aparecem no formato:

**DICA** 

Neste ponto está o texto da dica.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 7 de 50

2 Segurança X-AO 16 51

# 2 Segurança

É imprescindível ler informações de segurança, avisos e instruções neste documento. Apenas utilizar o produto observando todos os regulamentos e normas de segurança.

Este produto é operado com SELV ou PELV. Do módulo em si não emana nenhum perigo. Utilização na área Ex é permitida apenas com medidas adicionais.

# 2.1 Utilização prevista

Componentes HIMax são previstos para a instalação de sistemas de comando direcionados à segurança.

Para a utilização de componentes no sistema HIMax devem ser satisfeitos os seguintes requisitos.

# 2.1.1 Requisitos de ambiente

Tipo de requisito	Faixa de valores
Classe de proteção	Classe de proteção III conforme IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40+85 °C
Contaminação	Grau de contaminação II conforme IEC/EN 61131-2
Altura de instalação	< 2000 m
Caixa	Padrão: IP 20
Tensão de alimentação	24 VDC

Tabela 2: Requisitos de ambiente

Condições de ambiente diferentes das indicadas neste manual podem levar a avarias operacionais do sistema HIMax.

# 2.1.2 Medidas de proteção contra ESD

Apenas pessoal com conhecimentos sobre medidas de proteção contra ESD pode efetuar alterações ou ampliações do sistema ou a substituição de módulos.

#### **NOTA**



Danos no equipamento por descarga eletrostática!

- Usar para os trabalhos um posto de trabalho protegido contra descarga eletrostática e usar uma fita de aterramento.
- Guardar o aparelho protegido contra descarga eletrostática, p. ex., na embalagem.

Página 8 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

X-AO 16 51 2 Segurança

# 2.2 Perigos residuais

Do módulo HIMax em si não emana nenhum perigo.

Perigos residuais podem ser causados por:

- Erros do projeto
- Erros no programa de aplicação
- Erros na fiação

# 2.3 Medidas de precaução de segurança

Observar as normas de segurança em vigor no local de utilização e usar o equipamento de proteção prescrito.

# 2.4 Informações para emergências

Um sistema de comando HIMax é parte da tecnologia de segurança de uma instalação. A falha do sistema de comando coloca a instalação no estado seguro.

Em casos de emergência é proibida qualquer intervenção que impeça a função de segurança dos sistemas HIMax.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 9 de 50

# 3 Descrição do produto

O módulo padrão X-AO 16 51 é um módulo analógico de saída e destina-se à utilização no sistema eletrônico programável (PES) HIMax.

O módulo pode ser utilizado em todos os slots do suporte básico, exceto nos slots para os módulos de barramento de sistema, maiores detalhes no Manual de sistema HI 801 242 P.

O módulo é equipado com 16 saídas analógicas com uma faixa nominal de 4...20 mA.

As saídas analógicas são adequadas para a ligação de cargas ôhmicas, indutivas, capacitivas e lâmpadas conforme EN 61131-2.

As saídas do módulo de saída X-AO 16 51 não são galvanicamente separadas e por isso não podem ser ligadas de forma redundante. Para uma ligação de redundância de saídas analógicas, deve ser usado o módulo de saída seguro X-AO 16 01.

O módulo padrão pode ser operado junto com módulos direcionados à segurança em um suporte básico.

O módulo padrão é sem retroalimentação para os módulos direcionados à segurança. Isso inclui especialmente CEM, segurança elétrica, comunicação para X-SB e X-CPU e o programa de aplicação.

O módulo e a Connector Board são codificados mecanicamente, ver Capítulo 3.6.1. Assim evita-se que o módulo direcionado à segurança seja substituído por um módulo padrão.

As normas pelas quais os módulos e o sistema HIMax são verificados e certificados podem ser consultadas no Manual de segurança HI 801 241 P.

# 3.1 Função de segurança

O módulo não realiza nenhuma função relacionada à segurança.

Os parâmetros e status deste módulo não podem ser utilizados para funções de segurança.

# 3.1.1 Reação em caso de erro

O módulo ativa o LED Error na placa frontal.

#### 3.2 Volume de fornecimento

O módulo precisa para a operação de uma Connector Board compatível. Ao usar um FTA, um cabo de sistema é necessário para conectar a Connector Board com o FTA. As Connector Boards, o cabo de sistema e os FTAs não fazem parte do volume de fornecimento do módulo.

A descrição das Connector Boards ocorre no Capítulo 3.6, a dos cabos de sistema no Capítulo 3.7. Os FTAs são descritos em manuais separados.

Página 10 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 3.3 Placa de identificação

A placa de identificação contém os seguintes dados importantes:

- Nome do produto
- Marca de certificação
- Código de barras (código 2D ou traços)
- Número de peça (Part-No.)
- Índice de revisões do hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisões do software (SW-Rev.)
- Tensão de operação (Power)
- Dados Ex (se cabível)
- Ano de fabricação (Prod-Year:)



Figura 1: Placa de identificação, como exemplo

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 11 de 50

#### 3.4 Estrutura

O módulo é equipado com 16 saídas analógicas de corrente (0/4...20 mA) que não são galvanicamente separadas da tensão de alimentação e dos demais pares de canais. O valor analógico de corrente é ajustado através de um conversor D/A.

O sistema de processadores do módulo de E/S direcionado à segurança comanda e supervisiona o nível de E/S. Os dados e estados do módulo de E/S são transmitidos aos módulos de processador mediante o barramento de sistema redundante. O barramento de sistema é configurado como redundante por motivos da disponibilidade. A redundância apenas está garantida se ambos os módulos do barramento de sistema foram encaixados no suporte básico e configurados no SILworX.

# 3.4.1 Diagrama de blocos

O seguinte diagrama de blocos mostra a estrutura do módulo.

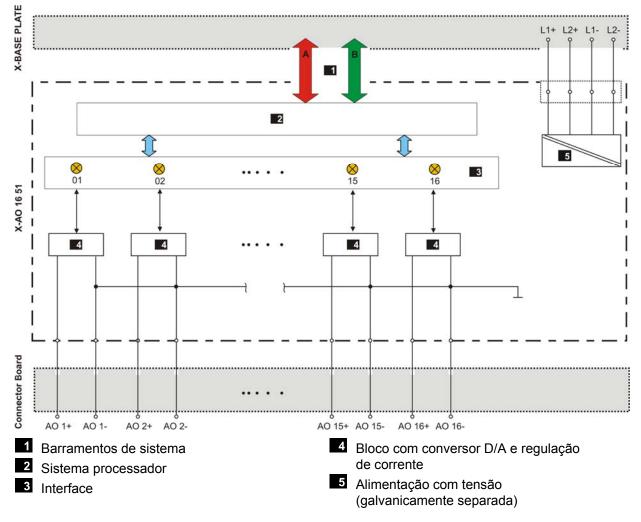


Figura 2: Diagrama de blocos do módulo

Página 12 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 3.4.2 Indicador

A figura a seguir reproduz o indicador do módulo:

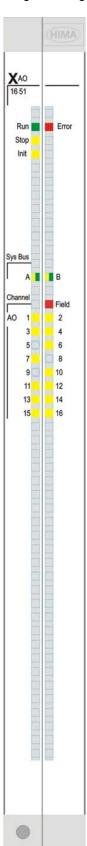


Figura 3: Indicador

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 13 de 50

Os diodos luminosos indicam o estado operacional do módulo.

Os diodos luminosos do módulo são divididos em três categorias:

- Indicador de status do módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicador de barramento de sistema (A, B)
- Indicador E/S (AO 1...16, Field)

Ao ligar a tensão de alimentação sempre ocorre um teste dos diodos luminosos no qual por um breve momento todos os diodos luminosos acendem.

# Definição das frequências de piscar:

Na tabela a seguir são definidas as frequências de piscar dos LEDs:

Nome	Frequência de piscar
Piscar1	liga longo (aprox. 600 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar2	liga curto (aprox. 200 ms), desliga curto (aprox. 200 ms), liga curto (aprox. 200 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar x	Comunicação Ethernet: Piscando no ritmo da transmissão de dados

Tabela 3: Frequências de piscar dos diodos luminosos

#### 3.4.3 Indicador de status do módulo

Estes diodos luminosos estão montados na parte superior da placa frontal.

LED	Cor	Status	Significado
Run	Verde	Liga	Módulo no estado RUN, operação normal
		Piscar1	Módulo no estado
			STOP/OS_DOWNLOAD ou
			RUN/UP STOP (só para módulos de processador)
		Desliga	Módulo não no estado RUN,
			observar os demais LEDs de status
Error	Vermelho	Liga/Piscar1	A falha interna do módulo detectada mediante auto-teste, p. ex., falha de hardware,
			software ou falhas da alimentação com tensão.
			Falhas ao carregar o sistema operacional
		Desliga	Operação normal
Stop	<b>Amarelo</b>	Liga	Módulo no estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Piscar1	Módulo no estado
			STOP/INVALID CONFIGURATION ou
			STOP/OS_DOWNLOAD
		Desliga	Módulo não está no estado STOP,
			observar os demais LEDs de status
Init	Amarelo	Liga	Módulo no estado INIT
		Piscar1	Módulo no estado LOCKED
		Desliga	O módulo não está no estado INIT nem em
			LOCKED, observar os demais LEDs de status

Tabela 4: Indicador de status do módulo

Página 14 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 3.4.4 Indicador de barramento de sistema

Os diodos luminosos para o indicador de barramento de sistema possuem a inscrição Sys Bus.

LED	Cor	Status	Significado
Α	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 1
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 1
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 1 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
В	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 2
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 2
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 2 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
A+B	Desliga	Desliga	Sem conexão lógica e física aos módulo de barramento de sistema nos slots 1 e 2

Tabela 5: Indicador de barramento de sistema

# 3.4.5 Indicador de E/S

Os diodos luminosos do indicador de E/S possuem a inscrição Channel.

LED	Cor	Status	Significado
Channel	<b>Amarelo</b>	Liga	Nível High ativo, corrente ≥ 4 mA
116		Piscar2	Erro de canal, corrente não igual ao valor de ajuste
		Desliga	Nível Low ativo, corrente < 4 mA
Field	Vermelho	Piscar2	Erro de campo em no mínimo um canal ou alimentação (p. ex., sobrecorrente)
		Desliga	Lado de campo sem erros

Tabela 6: Diodos luminosos do indicador de E/S

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 15 de 50

# 3.5 Dados do produto

Informações gerais	
Tensão de alimentação	24 VDC, -15%+20%, w <sub>s</sub> ≤ 5%, SELV, PELV
Consumo de corrente	máx. 1,3 A
Consumo de corrente, todas as saídas desligadas	mín. 0,6 A
Consumo de corrente por canal	80 mA
Temperatura de operação	0 °C+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C+85 °C
Umidade	máx. de 95% de umidade relativa, sem condensação
Grau de proteção	IP 20
Dimensões (H x L x P) em mm	310 x 29,2 x 230
Massa	aprox. 1,2 kg

Tabela 7: Dados do produto

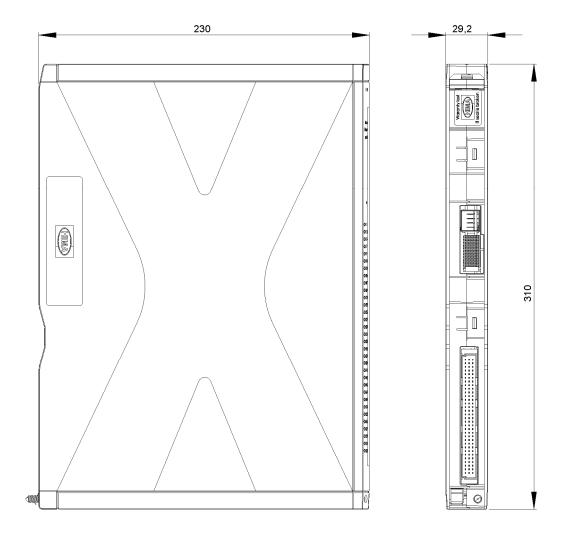


Figura 4: Vistas

Página 16 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

Saídas analógicas	
Quantidade de saídas analógicas	16
	As saídas analógicas não são
	galvanicamente separadas da tensão
	de alimentação nem entre si.
Faixa nominal	420 mA
Faixa de uso	022,5 mA
Resolução digital	16 Bit (10 000 digit no SILworX)
Valor LSB	≤ 2 µA
Carga ôhmica	máx. 600 Ω
Carga indutiva	máx. 1 mH
Carga capacitiva	máx. 100 μF em paralelo à carga ôhmica
Tempo de resposta	5 ms
Tempo de desligamento em caso de erro (Passagem ao estado seguro)	16 ms
Precisão técnica de medição	
Precisão técnica de medição a 25 °C, máx.	≤ ±0,2% do valor final
Precisão técnica de medição na faixa de temperatura total, máx.	≤ ±0,5% do valor final
Coeficiente de temperatura, máx.	≤ ±0,05%/K do valor final
Precisão técnica de medição na comunicação HART, máx.	≤ ±2% do valor final
Erro de linearidade, máx.	≤ ±0,1%
Precisão de segurança técnica	≤ ±2% do valor final

Tabela 8: Dados técnicos das saídas analógicas

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 17 de 50

#### 3.6 Connector Boards

Uma Connector Board conecta o módulo ao nível de campo. O módulo e a Connector Board em conjunto formam uma unidade funcional. Antes da instalação do módulo, montar a Connector Board no slot previsto.

As seguintes Connector Boards estão disponíveis para o módulo:

Connector Board	Descrição
X-CB 014 51	Connector Board com bornes aparafusados
X-CB 014 53	Connector Board com conector de cabo

Tabela 9: Connector Boards disponíveis

# 3.6.1 Codificação mecânica de Connector Boards

Módulos de E/S e Connector Boards são codificados mecanicamente a partir da Revisão AS00 do hardware para impedir o equipamento com módulos de E/S incompatíveis. Pela codificação é excluído o equipamento incorreto e assim, eliminam-se as consequências para o campo. Além disso, o equipamento com módulos incorretos não influencia o sistema HIMax, pois apenas módulos corretamente configurados no SILworX entram no modo RUN.

Módulos de E/S e as Connector Board correspondentes são equipados com uma codificação mecânica em forma de cunhas. As cunhas de codificação no conector F da Connector Board entram nos recessos do conector M do módulo de E/S, veja Figura 5.

Módulos de E/S codificados apenas podem ser inseridos nas Connector Boards correspondentes.

Página 18 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

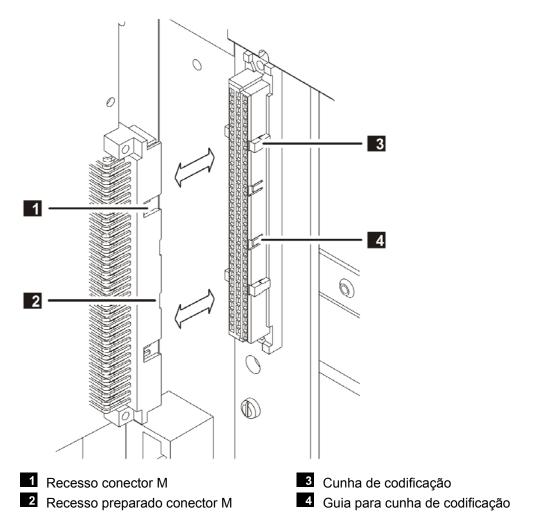


Figura 5: Exemplo de uma codificação

Módulos de E/S codificados apenas podem ser colocados em Connector Board não codificadas. Módulos de E/S não codificados não podem ser colocados em Connector Boards codificadas.

# 3.6.2 Codificação de Connector Boards X-CB 014 5X

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
X	X		X			X	

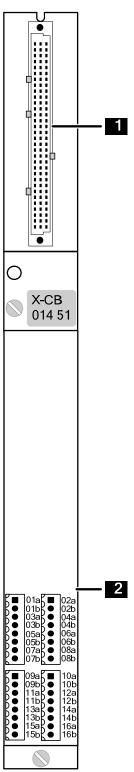
Tabela 10: Posição das cunhas de codificação

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 19 de 50

# 3.6.3 Connector Boards com bornes aparafusados

# Mono

X-CB 014 51



1 Conectores de módulos de E/S

Conexão lado de campo (bornes aparafusados)

Figura 6: Connector Boards com bornes aparafusados

Página 20 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 3.6.4 Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados

Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	01a	AO1+	1	02a	AO2+
2	01b	AO1-	2	02b	AO2-
3	03a	AO3+	3	04a	AO4+
4	03b	AO3-	4	04b	AO4-
5	05a	AO5+	5	06a	AO6+
6	05b	AO5-	6	06b	AO6-
7	07a	AO7+	7	08a	AO8+
8	07b	AO7-	8	08b	AO8-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	09a	AO9+	1	10a	AO10+
2	09b	AO9-	2	10b	AO10-
3	11a	AO11+	3	12a	AO12+
4	11b	AO11-	4	12b	AO12-
5	13a	AO13+	5	14a	AO14+
6	13b	AO13-	6	14b	AO14-
7	15a	AO15+	7	16a	AO16+
8	15b	AO15-	8	16b	AO16-

Tabela 11: Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados

A ligação do lado de campo ocorre com conectores de bornes que são encaixados nas réguas de pinos da Connector Board.

Os conectores de bornes possuem as seguintes características:

Ligação lado de campo	
Conector de bornes	4 un., 8 pinos
Seção transversal do condutor	0,21,5 mm <sup>2</sup> (unifilar) 0,21,5 mm <sup>2</sup> (fio fino) 0,21,5 mm <sup>2</sup> (com terminal tubular)
Comprimento de decapagem	6 mm
Chave de fenda	Fenda 0,4 x 2,5 mm
Binário de aperto	0,20,25 Nm

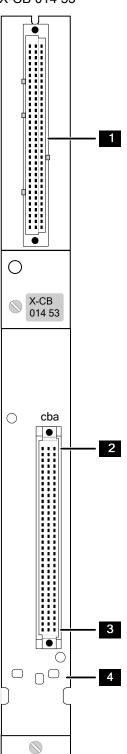
Tabela 12: Características dos conectores de bornes

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 21 de 50

# 3.6.5 Connector Boards com conector de cabo

# Mono

X-CB 014 53



- 1 Conectores de módulos de E/S
- Ligação lado de campo (conector de cabo linha 1)
- Ligação lado de campo (conector de cabo linha 32)
- 4 Codificação para conectores de cabo

Figura 7: Connector Boards com conector de cabo

Página 22 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

3.6.6 Atribuição de conectores Mono Connector Board com conector de cabo Para esta Connector Board, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7.

Os conectores de cabo e as Connector Boards são codificados.

Atribuição de conectores!

A seguinte tabela descreve a atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100:

Linha	С		b		а	
Lillia	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor
1	livre		livre		U1-D1A	amarelo-preto
2	livre		livre		U1-D1B	verde-preto
3	livre		livre		U1-D2A	amarelo- vermelho
4	livre		livre		U1-D2B	verde-vermelho
5	livre		livre			
6	livre		livre			
7	livre		livre			
8	livre		livre			
9	livre		livre			
10	livre		livre			
11	livre		livre			
12	livre		livre			
13	livre		livre			
14	livre		livre			
15	livre		livre			
16	livre		livre			
17	AO16+	amarelo-azul	AO16-	verde-azul		
18	AO15+	amarelo-rosa	AO15-	rosa-verde		
19	AO14+	amarelo-cinza	AO14-	cinza-verde		
20	AO13+	marrom-preto	AO13-	branco-preto		
21	AO12+	marrom- vermelho	AO12-	branco- vermelho		
22	AO11+	marrom-azul	AO11-	branco-azul		
23	AO10+	rosa-marrom	AO10-	branco-rosa		
24	AO9+	cinza-marrom	AO9-	branco-cinza		
25	AO8+	amarelo- marrom	AO8-	branco- amarelo		
26	AO7+	marrom-verde	AO7-	branco-verde		
27	AO6+	vermelho-azul	AO6-	cinza-rosa		
28	AO5+	violeta	AO5-	preto		
29	AO4+	vermelho	AO4-	azul		
30	AO3+	rosa	AO3-	cinza		
31	AO2+	amarelo	AO2-	verde		
32	AO1+	marrom	AO1-	branco		

Tabela 13: Atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema

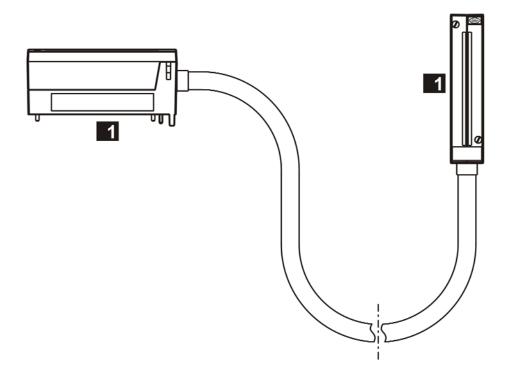
HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 23 de 50

# 3.7 Cabo de sistema X-CA 011

O cabo de sistema X-CA 011 conecta as Connector Boards X-CB 014 53 com os Field Termination Assemblies.

Informações gerais	
Cabo	LIYCY-TP 18 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Condutor	Fio fino
Diâmetro externo médio (d)	aprox. 12,7 mm
Raio mínimo de dobradura instalação fixa móvel	5 x d 10 x d
Comportamento de combustão	resistente a chamas e auto-extintor conf. IEC 60332-1-2 -2-2
Comprimento	830 m
Codificação de cores	Orientado na DIN 47100, veja Tabela 13.

Tabela 14: Dados de cabo



1 Conectores de cabo idênticos

Figura 8: Cabo de sistema X-CA 011 01 n

O cabo de sistema está disponível nas seguintes variantes, veja tabela:

Cabo de sistema	Descrição	Comprimento
X-CA 011 01 8	Conectores de cabos de ambos os lados.	8 m
X-CA 011 01 15		15 m
X-CA 011 01 30		30 m

Tabela 15: Cabos de sistema disponíveis

Página 24 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 3.7.1 Codificação do conector de cabo

Os conectores de cabo são equipados com três pinos de codificação. Desta forma, os conectores de cabos apenas podem ser inseridos em Connector Boards e FTAs com os respectivos recessos, veja Figura 7.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 25 de 50

# 4 Colocação em funcionamento

Este capítulo descreve a instalação e configuração do módulo e suas variantes de ligação. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

# 4.1 Montagem

É necessário observar os seguintes pontos durante a montagem:

- Somente operar com os componentes de ventilação correspondentes, veja Manual de sistema HI 801 242 P.
- Somente operar com a Connector Board correspondente, veja Capítulo 3.6.
- O módulo inclusive suas peças de conexão deve ser configurado para alcançar no mínimo o grau de proteção IP 20 conf. EN 60529: 1991 + A1:2000.

#### NOTA



Danos por ligação incorreta!

Não-observância pode resultar em danos nos componentes eletrônicos. Os seguintes pontos devem ser observados.

- Conectores e bornes do lado de campo
  - Na ligação dos conectores e bornes ao lado de campo, observar medidas adequadas de aterramento.
  - Utilizar um cabo blindado com pares de fios trançados.
  - Utilizar para cada entrada de medição um par trançado do cabo blindado.
  - Colocar a blindagem do lado do módulo no trilho de blindagem de cabos (usar borne de conexão de blindagem SK 20 ou equivalente).
  - No caso de condutores multifilares, a HIMA recomenda colocar terminais tubulares nas extremidades dos condutores. Os bornes de ligação devem ser adequados para a conexão das bitolas dos condutores utilizados.

# 4.1.1 Ligação de saídas não utilizadas

Saídas ão utilizadas podem permanecer abertas e não precisam ser terminadas. Para evitar curtos-circuitos no campo, não é permitido conectar condutores com pontas abertas do lado de campo às Connector Boards.

Página 26 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 4.2 Instalação e desinstalação do módulo

Este capítulo descreve a substituição de um módulo existente ou a inserção de um módulo novo.

Ao desmontar um módulo, a Connector Board permanece no suporte básico HIMax. Isso evita fiação dispendiosa adicional nos bornes de ligação, pois todas as ligações de campo são ligadas através da Connector Board do módulo.

# 4.2.1 Montagem de uma Connector Board

Ferramentas e meios auxiliares

- Chave de fenda, fenda 0.8 x 4.0 mm
- Connector Board compativel

#### **Montar a Connector Board:**

- 1. Inserir a Connector Board com a ranhura para cima no trilho guia (veja a este respeito o desenho na continuação). Engatar a ranhura no pino do trilho guia.
- 2. Apoiar a Connector Board sobre o trilho de blindagem de cabo.
- 3. Aparafusar ao suporte básico mediante os dois parafusos a prova de perda. Primeiramente inserir o parafuso inferior, depois o superior.

#### **Desmontar a Connector Board:**

- 1. Desparafusar do suporte básico os dois parafusos a prova de perda.
- 2. Levantar a Connector Board do trilho de blindagem de cabo na parte inferior.
- 3. Puxar a Connector Board para fora do trilho guia.

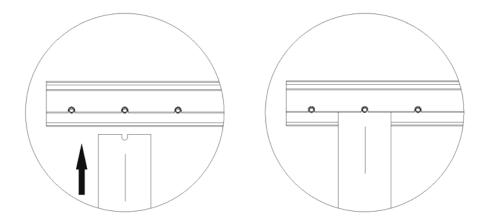


Figura 9: Inserir a Connector Board

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 27 de 50

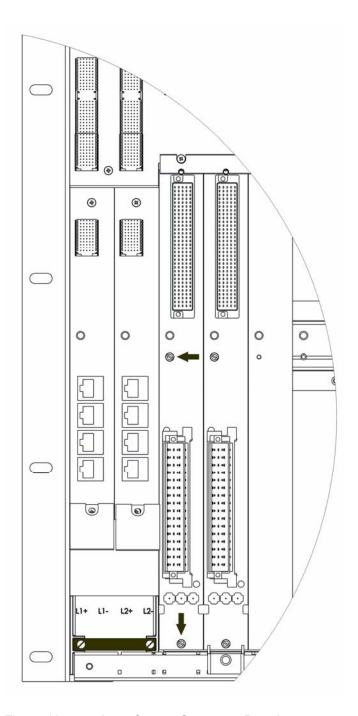


Figura 10: Aparafusar a Connector Board

Página 28 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 4.2.2 Instalação e desinstalação de um módulo

Este capítulo descreve a instalação e desinstalação de um módulo HIMax. Um módulo pode ser instalado e desinstalado enquanto o sistema HIMax está em operação.

#### NOTA



Danos nos conectores de encaixe por emperramento! Não-observância pode resultar em danos no sistema de comando. Sempre inserir o módulo no suporte básico de forma cautelosa.

#### Ferramentas

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Chave de fenda, fenda 1,2 x 8,0 mm

#### Instalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
  - ☑ Colocar as travas para a posição open aberta
  - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Inserir o módulo na parte superior no perfil de encaixe, veja 1.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para dentro do suporte básico e engatar com leve pressão, veja 2.
- 4. Aparafusar o módulo, veja 3.
- 5. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 6. Travar a chapa de cobertura.

# Desinstalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
  - ☑ Colocar as travas na posição open aberta
  - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Soltar o parafuso, veja 3.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para fora do suporte básico e empurrar com leve pressão para cima, veja 2 e 1.
- 4. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 5. Travar a chapa de cobertura.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 29 de 50

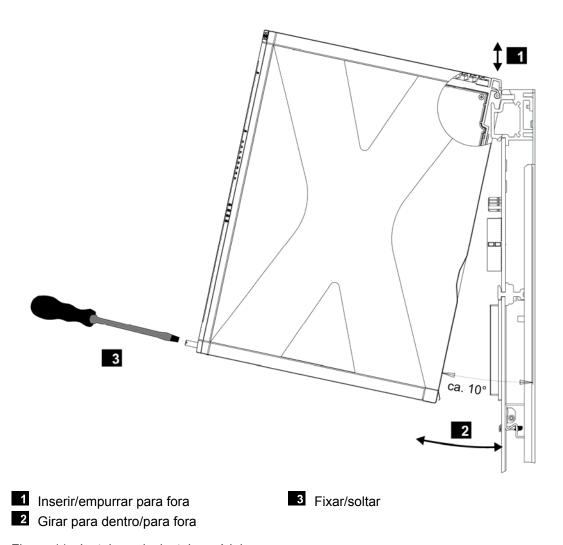


Figura 11: Instalar e desinstalar módulo

Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador apenas brevemente durante a operação do sistema HIMax (< 10 min), pois isso prejudica a convecção forçada de ar.

Página 30 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 4.3 Configuração do módulo no SILworX

O módulo é configurado no Hardware Editor da ferramenta de programação SILworX.

Observar os seguintes pontos durante a configuração:

Para o diagnóstico do módulo e dos canais, é possível avaliar adicionalmente ao valor de medição todos os parâmetros de sistema no programa de aplicação. Informações mais detalhadas sobre os parâmetros de sistema podem ser encontradas nas tabelas a partir do Capítulo 4.3.1.

Para a avaliação dos parâmetros de sistema no programa de aplicação, devem ser atribuídas variáveis globais aos parâmetros de sistema. Executar este passo no Hardware Editor, na visualização de detalhe do módulo.

As seguintes tabelas contêm os parâmetros de sistema do módulo na mesma ordem como no Hardware Editor.

#### DICA

Para a conversão dos valores hexadecimais em sequências de Bits é útil, p. ex., a calculadora do Windows<sup>®</sup>, na visão **científico**.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 31 de 50

# 4.3.1 Registro Module

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema do módulo:

Nome		R/W	Descrição		
Estes status e parâm	netros são ir	ntroduzio	dos diretamente no Hardware Editor.		
Name W			Nome do módu	lo	
Noise Blanking W		X	(Ativado/Desatir Ajuste padrão: A O módulo proce avaria transient	Permitir supressão de avarias pelo módulo processador (Ativado/Desativado). Ajuste padrão: Ativado. O módulo processador retarda a reação de erro após uma avaria transiente até o tempo de segurança. O último valor de processo válido permanece para o programa de aplicação.	
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição		
Os seguintes status de aplicação.	e parâmetro	s poder	n ser atribuídos a	a variáveis globais e usados no programa	
Module OK	BOOL	R	FALSE: Erro de módulo	e um canal (sem erros externos).	
			•	âmetro <i>Module Status</i> !	
Module Status	DWORD	R	Status do módu		
			Codificação	Descrição	
			0x00000001	Erro do módulo 1)	
			0x00000002	Limiar de temperatura 1 ultrapassado	
			0x00000004	Limiar de temperatura 2 ultrapassado	
			0x00000008	Valor de temperatura com erro	
			0x00000010	Tensão em L1+ com erro	
			0x00000020	Tensão em L2+ com erro	
			0x00000040	Tensões internas com erro	
			0x02000000	Erro num FPGA Header	
			0x04000000	Erro na supervisão de 2,5 V.	
			0x08000000	Erro na supervisão de 3,3 V.	
			0x10000000	Erro na supervisão de 1,2 V.	
			0x20000000	Erro na supervisão de 15 V.	
			0x40000000	Erro na supervisão de 24 V.	
			0x80000000	Sem conexão ao módulo 1)	
			e não preci programa d	s possuem efeito sobre o status <i>Module OK</i> isam ser avaliados especificamente no de aplicação.	
Timestamp [µs]	DWORD	R		ossegundos do carimbo de tempo. edição das saídas analógicas	
Timestamp [s]	DWORD	R		ındos do carimbo de tempo.	
Timestamp [5]	DVVOIND	13		edição das saídas analógicas.	

Tabela 16: Registro Module no Hardware Editor

Página 32 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 4.3.2 Registro I/O Submodule AO16\_01

O registro **I/O Submodule AO16\_01** contém os seguintes parâmetros de sistema:

Nome		R/W	Descrição		
Estes status e parâmetros são introduzidos diretamente no Hardware Editor.					
Name		R	Nome do módulo		
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição		
Os seguintes status e pa de aplicação.	râmetros po	dem ser	atribuídos a variáveis globais e usados no programa		
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Teste de fundo com erro FALSE: Teste de fundo sem erro		
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar um valor diagnóstico, deve ser transmitida ao módulo a respectiva ID (codificação veja 4.3.5) pelo parâmetro <i>Diagnostic Request</i> .		
Diagnostic Response	DINT	R	Logo que a <i>Diagnostic Response</i> retornar a ID da <i>Diagnostic Request</i> (codificação veja 4.3.5), o <i>Diagnostic Status</i> exibirá o valor de diagnóstico solicitado.		
Diagnostic Status	DWORD	R	O valor de diagnóstico solicitado conforme Diagnostic Response.  No programa de aplicação é possível avaliar as IDs das Diagnostic Request e das Diagnostic Response. Só quando ambas tiverem a mesma ID, o Diagnostic Status irá conter o valor de diagnóstico solicitado.		
Restart on Error	BOOL	W	Cada módulo de E/S que estiver permanentemente desligado devido a erros, pode ser reconduzido ao estado RUN com ajuda do parâmetro Restart on Error. Para este fim, colocar o parâmetro Restart on Error de FALSE para TRUE.  O módulo de E/S executa um autoteste completo e apenas assume o status RUN se nenhum erro foi detectado.  Ajuste padrão: FALSE		
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: sem erros de sub-módulo sem erros de canal. FALSE: erros de sub-módulo erros de canal de um canal (também erros externos)		
Submodule Status	DWORD	R	Status do sub-módulo codificado por Bits (codificação veja 4.3.4)		

Tabela 17: Registro I/O Submodule AO16\_01 no Hardware Editor

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 33 de 50

# 4.3.3 Registro I/O Submodule AO16\_01: Channels

O registro **I/O Submodule AO16\_01: Channels** contém os seguintes parâmetros de sistema para cada entrada analógica.

É possível atribuir variáveis globais aos parâmetros de sistema com -> e, assim, usar as mesmas no programa de aplicação. Os valores sem -> devem ser introduzidos diretamente.

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Channel no.		R	Número de canal, definição fixa
Process Value REAL R [REAL] ->		R	Valor de processo que é convertido em um valor de corrente com ajuda dos pontos de apoio 4 mA e 20 mA.
			O valor de processo 0.0 leva a uma corrente de saída se o valor de processo 0.0 estiver entre os dois pontos de apoio (p. ex., 4 mA = -60.0 e 20 mA = +60.0). Isso vale mesmo se nenhuma variável global estiver conectada ao parâmetro <i>Process Value -&gt;</i> .
4 mA	REAL	W	Ponto de apoio no valor final de escala inferior (4 mA) do canal.  Deve ser indicado o valor de processo para o qual 4 mA devem ser emitidos na saída.  Ajuste padrão: 4.0
			Se o canal não for usado, o ajuste padrão 4.0 deve estar introduzido.
20 mA	REAL	W	Ponto de apoio no valor final de escala superior (20 mA) do canal.  Deve ser indicado o valor de processo para o qual 20 mA devem ser emitidos na saída.  Ajuste padrão: 20.0
			Se o canal não for usado, o ajuste padrão 20.0 deve estar introduzido.
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: canal sem erros. O valor de saída é válido. FALSE: canal com erros. O valor de saída é colocado em 0.

Tabela 18: Registro I/O Submodule AO16\_01: Channels no Hardware Editor

Página 34 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 4.3.4 Submodule Status [DWORD]

Codificação do Submodule Status.

Codificação	Descrição
0x00000001	Erros da unidade de hardware (sub-módulo)
0x00000002	Reset de um barramento de E/S
0x00000004	Erro durante a configuração do hardware
0x00000008	Erro durante a verificação dos coeficientes
0x00000010	Primeiro limiar de temperatura ultrapassado (temperatura de alerta)
0x00000020	Segundo limiar de temperatura ultrapassado (temperatura limite)
0x00000040	O módulo está desligado por causa de sobrecorrente
0x00000080	Reset da supervisão chip select

Tabela 19: Submodule Status [DWORD]

# 4.3.5 Diagnostic Status [DWORD]

Codificação Diagnostic Status

ID	Descrição						
0	Valores de diagnóstico (1001016) são exibidos sequencialmente.						
100	Estado de temperatura codificado por Bit						
	0 = normal						
		r de temperatura 1 ultrapassado					
		r de temperatura 2 ultrapassado					
	Bit2 = 1 : Medic	ção de temperatura com erro					
101	Temperatura m	nedida (10 000 Digit/°C)					
200	Estado de tens	ão codificado por Bit					
	0 = normal						
	Bit0 = 1 : L1+ (	24 V) com erro					
	Bit1 = 1 : L2+ (	Bit1 = 1 : L2+ (24 V) com erro					
201	Não usado!						
202							
203							
300	Subtensão com 24 V (BOOL)						
10011016	Status de cana	l dos canais 116					
	Codificação	Descrição					
	0x0001	Erros da unidade de hardware					
	0x0002	Erro de canal devido a erro interno					
	0x0200	Valores limite ultrapassados ou não alcançados.					

Tabela 20: Diagnostic Status [DWORD]

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 35 de 50

# 4.4 Variantes de ligação

Este capítulo descreve a ligação técnica correta do módulo. As seguintes variantes de ligação são permitidas.

A ligação das saídas ocorre mediante Connector Boards.

# 4.4.1 Ligação de saída mono-canal

Na ligação conforme Figura 12, é possível utilizar as Connector Boards X-CB 014 51 (com bornes aparafusados) ou X-CB 014 53 (com conector de cabo).

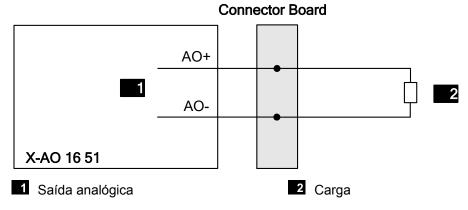


Figura 12: Ligação mono-canal

Página 36 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

### 4.4.2 Regulação

Existe um acoplamento físico entre o atuador da saída analógica AO e o transdutor de valor de medição da entrada analógica AI. Os dados de medição da AI são processados no módulo processador para os novos dados de ajuste da AO.

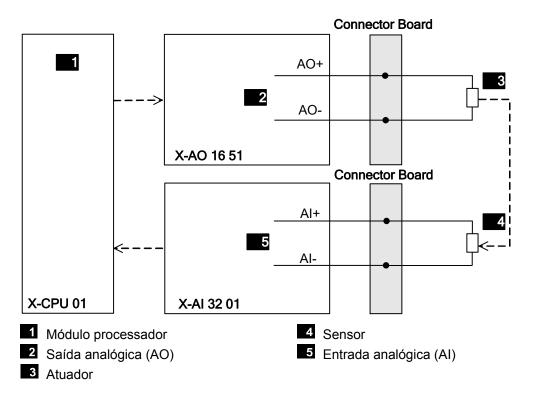


Figura 13: Ligação de regulação

Atrasos pelo processamento dos dados de processo do sistema de comando HIMax devem ser considerados.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 37 de 50

### 4.4.3 Ligação via Field Termination Assembly

A ligação via Field Termination Assembly X-FTA 002 01 ocorre como representado em Figura 14. Para informações mais detalhadas, veja os manuais X-FTA 002 01 e X-FTA 009 02L.

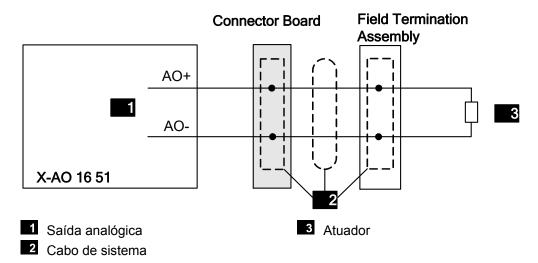


Figura 14: Ligação via Field Termination Assembly

### 4.4.4 Comportamento no caso de comunicação HART

Para a comunicação HART pode ser ligado um HART-Handheld em paralelo ao atuador. As oscilações de corrente causadas pela comunicação HART são compensadas em grande parte pela saída analógica, assim que o erro residual da medição analógica seja de 2% do valor final.

 $\overset{\bullet}{1} \qquad \text{Erro residual maior no caso de comunicação HART. Retirar o terminal HART} \\ \overset{\bullet}{\text{imediatamente após o diagnóstico!}}$ 

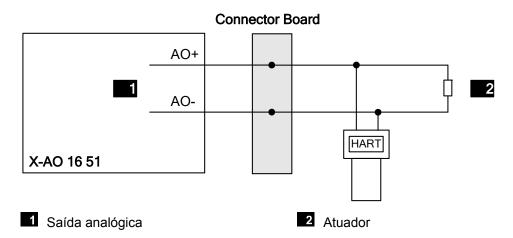


Figura 15: HART-Handheld em paralelo ao transmitter e ao módulo de saída

Página 38 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

X-AO 16 51 5 Operação

# 5 Operação

O módulo é operado num suporte básico HIMax e dispensa supervisão especial.

#### 5.1 Operação

A operação no módulo em si não está prevista.

A operação, p. ex., Forcing das saídas analógicas, ocorre via PADT. Detalhes sobre isso encontram-se na documentação do SILworX.

### 5.2 Diagnóstico

O estado do módulo é indicado pelos LEDs do lado frontal do módulo, veja Capítulo 3.4.2.

O histórico de diagnóstico do módulo pode ser lido adicionalmente com a ferramenta de programação SILworX. Nos Capítulos 4.3.4 e 4.3.5 são descritos os status de diagnóstico mais importantes.

Se um módulo é colocado em um suporte básico, o mesmo gera durante a inicialização mensagens diagnósticas que indicam disfunções ou valores de tensão incorretos. Estas mensagens não indicam uma falha do módulo se ocorrerem após a transição para a operação de sistema.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 39 de 50

## 6 Manutenção preventiva

Módulos defeituosos devem ser substituídos por módulos intactos do mesmo tipo ou de um tipo de substituição autorizado.

A reparação do módulo apenas pode ser efetuada pelo fabricante.

Para substituir módulos devem ser observados os requisitos do Manual do sistema HI 801 242 P e do Manual de segurança HI 801 241 P.

#### 6.1 Medidas de manutenção preventiva

#### 6.1.1 Carregar o sistema operacional

No contexto da melhora de produtos, a HIMA continua desenvolvendo o sistema operacional do módulo. A HIMA recomenda aproveitar paradas planejadas do sistema para carregar a versão atualizada do sistema operacional para os módulos.

O carregamento do sistema operacional é descrito no Manual de sistema ou na ajuda Online. Para carregar o sistema operacional, o módulo precisa estar no estado parado STOP.

A versão atual do do módulo encontra-se no Control Panel do SILworX. A placa de identificação mostra a versão no momento do fornecimento, veja Capítulo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

## 6.1.2 Repetição da verificação

Módulos HIMax devem ser submetidos a uma repetição da verificação em intervalos de 10 anos. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HI 801 241 P.

Página 40 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

# 7 Colocação fora de serviço

Puxar o módulo para fora do suporte básico para colocar fora de serviço. Detalhes sobre isso no Capítulo *Instalação e desinstalação do módulo*.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 41 de 50

8 Transporte X-AO 16 51

# 8 Transporte

Para a proteção contra danos mecânicos, os componentes HIMax devem ser transportados nas embalagens.

Sempre armazenar componentes HIMax nas embalagens originais dos produtos. As mesmas servem ao mesmo tempo à proteção contra ESD. A embalagem do produto sozinha não é suficiente para o transporte.

Página 42 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

X-AO 16 51 9 Eliminação

# 9 Eliminação

Clientes industriais assumem a responsabilidade pelo hardware HIMax colocado fora de funcionamento. Sob solicitação é possível firmar um acordo de descarte com a HIMA.

Encaminhar todos os materiais a uma eliminação correta em relação ao meio-ambiente.

HI 801 249 P Rev. 4.00 Página 43 de 50

9 Eliminação X-AO 16 51

Página 44 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

X-AO 16 51 Anexo

## **Anexo**

## Glossário

Conceito	Descrição
ARP	Address Resolution Protocol: Protocolo de rede para a atribuição de endereços
	de rede a endereços de hardware
Al	Analog Input: Entrada analógica
Connector Board	Placa de conexão para o módulo HIMax
COM	Módulo de comunicação
CRC	Cyclic Redundancy Check: Soma de verificação
DI	Digital Input: Entrada digital
DO	Digital Output: Saída digital
CEM	Compatibilidade eletromagnética
EN	Normas européias
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga eletrostática
FB	Fieldbus: barramento de campo
FBS	Funktionsbausteinsprache: linguagem de bloco funcional
FTT	Fault tolerance time: tempo de tolerância de falhas
ICMP	Internet Control Message Protocol: Protocolo de rede para mensagens
	de status e de falhas
IEC	Normas internacionais para eletrotécnica
Endereço MAC	Endereço de hardware de uma conexão de rede (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (conforme IEC 61131-3), PC com SILworX
PE	Terra de proteção
PELV	Protective Extra Low Voltage: Extra baixa tensão funcional com separação segura
PES	Programable Electronic System: Sistema eletrônico programável
PFD	Probability of Failure on Demand: Probabilidade de uma falha ao demandar
	uma função de segurança
PFH	Probability of Failure per Hour: Probabilidade de uma falha perigosa por hora
R	Read: Ler
Rack-ID	Identificação de um suporte básico (número)
Livre de efeitos	Dois circuitos de entrada estão ligados à mesma fonte (p. ex., transmissor).
de retro-	Uma ligação de entrada é chamada de "livre de efeitos de retroalimentação"
alimentação	se ela não interferir com os sinais de uma outra ligação de entrada.
R/W	Read/Write: Ler/Escrever
SB	Systembus: (módulo do) barramento de sistema
SELV	Safety Extra Low Voltage: Tensão extra baixa de proteção
SFF	Safe Failure Fraction: Fração de falhas que podem ser controladas com segurança
SIL	Safety Integrity Level (conf. IEC 61508)
SILworX	Ferramenta de programação para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	System.Rack.Slot Endereçamento de um módulo
SW	Software
TMO	Timeout
TMR	Triple Module Redundancy: módulos com tríplice redundância
W	Write
W <sub>S</sub>	Valor limite do componente total de corrente alternada
Watchdog (WD)	Supervisão de tempo para módulos ou programas. O ultrapassar o tempo do Watchdog, o módulo ou programa entre em parada por erro.
WDZ	Tempo de Watchdog
<u> </u>	· · ·

Anexo X-AO 16 51

Lista de f	iguras	
Figura 1:	Placa de identificação, como exemplo	11
Figura 2:	Diagrama de blocos do módulo	12
Figura 3:	Indicador	13
Figura 4:	Vistas	16
Figura 5:	Exemplo de uma codificação	19
Figura 6:	Connector Boards com bornes aparafusados	20
Figura 7:	Connector Boards com conector de cabo	22
Figura 8:	Cabo de sistema X-CA 011 01 n	24
Figura 9:	Inserir a Connector Board	27
Figura 10:	Aparafusar a Connector Board	28
Figura 11:	Instalar e desinstalar módulo	30
Figura 12:	Ligação mono-canal	36
Figura 13:	Ligação de regulação	37
Figura 14:	Ligação via Field Termination Assembly	38
Figura 15:	HART-Handheld em paralelo ao transmitter e ao módulo de saída	38

Página 46 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

X-AO 16 51 Anexo

Lista de t	abelas	
Tabela 1:	Manuais adicionalmente em vigor	5
Tabela 2:	Requisitos de ambiente	8
Tabela 3:	Frequências de piscar dos diodos luminosos	14
Tabela 4:	Indicador de status do módulo	14
Tabela 5:	Indicador de barramento de sistema	15
Tabela 6:	Diodos luminosos do indicador de E/S	15
Tabela 7:	Dados do produto	16
Tabela 8:	Dados técnicos das saídas analógicas	17
Tabela 9:	Connector Boards disponíveis	18
Tabela 10:	Posição das cunhas de codificação	19
Tabela 11:	Atribuição de bornes de Mono Connector Board com bornes aparafusados	21
Tabela 12:	Características dos conectores de bornes	21
Tabela 13:	Atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema	23
Tabela 14:	Dados de cabo	24
Tabela 15:	Cabos de sistema disponíveis	24
Tabela 16:	Registro Module no Hardware Editor	32
Tabela 17:	Registro I/O Submodule AO16_01 no Hardware Editor	33
Tabela 18:	Registro I/O Submodule AO16_01: Channels no Hardware Editor	34
Tabela 19:	Submodule Status [DWORD]	35
Tabela 20:	Diagnostic Status [DWORD]	35

Anexo X-AO 16 51

# Índice remissivo

Comunicação HART	38
Connector Board	
Com bornes aparafusados	20
Com conector de cabo	22
Dados do produto	
Módulo	16
Dados técnicos	
Saidas	17

Diagnostico	39
Indicador de barramento de sistema	15
Indicador de E/S	15
Diagrama de blocos	12
Função de segurança	10
Indicador de status do módulo	

Página 48 de 50 HI 801 249 P Rev. 4.00

X-AO 16 51 **Anexo** 



HI 801 249 P © 2011 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax e SILworX são marcas registradas da: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemanha Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



